|  |  |
| --- | --- |
| Информация о заказчике | |
| Название фирмы |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о заказе | |
| Наименование платы (должно совпадать с названием файла) |  |
| Количество плат (если заготовки – указать), шт. |  |
| Новый заказ / повтор (старая информация, изменения) | Новый заказ |
| Срок изготовления | Обычный |
| Точные размеры платы, мм, допуск на размер |  |
| Материал платы (FR4, МИ1222, СФ, др.) |  |
| Толщина фольги (18, 35 мкм, другая) |  |
| Толщина платы, мм. |  |
| Тип платы (ОПП, ДПП, МПП – кол-во слоев) |  |
| Формат файла (Gerber, ACCELL, PCAD, версия) | CAM8.0 |
| Единицы изм. (только для PCAD – мм, дюйм, псевдо) |  |
| Для ОПП в PCAD4.5 указать зеркалить топологию или нет |  |
| Маска по меди (да / нет) |  |
| Переходные отверстия открыты от маски (да / нет) |  |
| Маркировка (да / нет, кол-во сторон) |  |
| Цвет маркировки (белый, черный) |  |
| Защитное покрытие (лужение, Ni-Au) | Лужение |
| Защита разъема от лужения (да / нет) |  |
| Обработка контура (фрезеровка, гильотина) |  |
| Внутренние вырезы (да / нет) |  |
| Допуск на отверстие (±) |  |
| Дополнительная информация |  |
|  |  |

**Перечень технологических слоев (названия слоев в CAD системе или имена файлов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Топология стороны компонентов (прямая) | | Top |
| Топология стороны пайки (зеркальная) | | Bottom |
| Маска со стороны компонентов | | TopMask |
| Маска со стороны пайки | | BotMask |
| Маркировка со стороны компонентов | |  |
| Маркировка со стороны пайки | |  |
| Контур платы | |  |
| Сверловка (металлизированные отверстия) | |  |
| Сверловка (неметаллизированные отверстия) | |  |
| Слой трафаретной печати | |  |
| Внутренние слои МПП (планы питания, выполненные в негативе, пометить NEGATIV) | | |
| Внутренний слой 1 | |  |
| Внутренний слой 2 | |  |
| Внутренний слой 3 | |  |
| Внутренний слой 4 | |  |
| Дополнительная  информация |  | |